

Bienvenue chez O-Leading

O-Leading s'efforce d'être votre partenaire de solution unique dans la chaîne d'approvisionnement EMS, y compris la conception de PCB, la fabrication de PCB et l'assemblage de PCB (PCBA). Nous fournissons certaines des technologies de PCB les plus avancées, y compris les PCB HDI, PCB multicouches, PCB rigides et flexibles. Nous pouvons prendre en charge du prototype à virage rapide à la production moyenne et de masse.

En général, nos clients mondiaux sont très impressionnés par nos services: une réponse rapide, un prix compétitif et un engagement de qualité.

En regardant vers l'avenir, O-leader se concentrera sur l'innovation et le développement de la technologie de fabrication électronique comme toujours, et déploiera des efforts persistants sur le service unique PCB & PCBA pour fournir des services de première classe et créer plus de valeur pour nos clients.

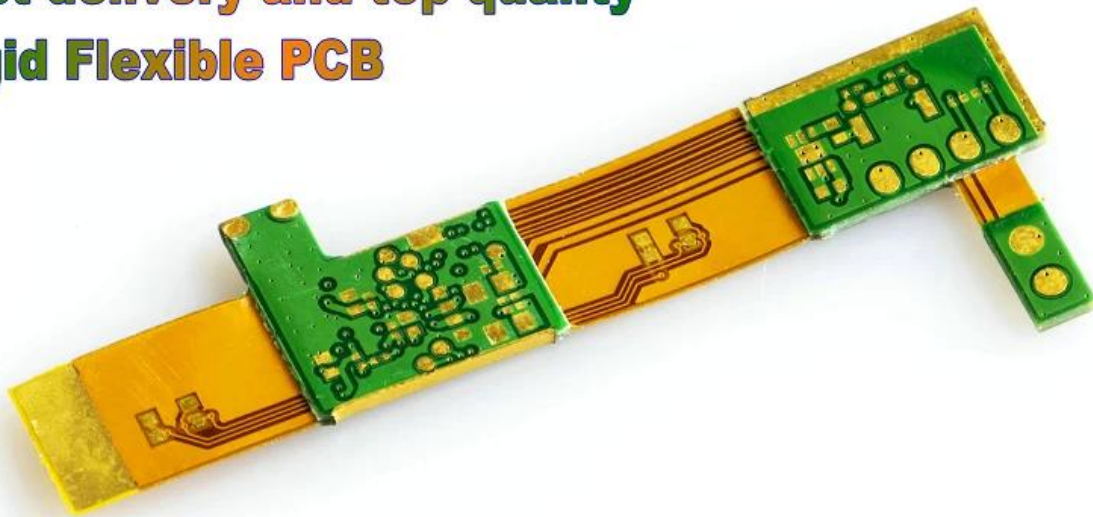
VEUILLEZ CLIQUER ICI POUR PLUS D'INFORMATIONS: [X-RAY Inspection BGA Assembly IC](#)
[Programmation One-stop PCB Assembly](#)

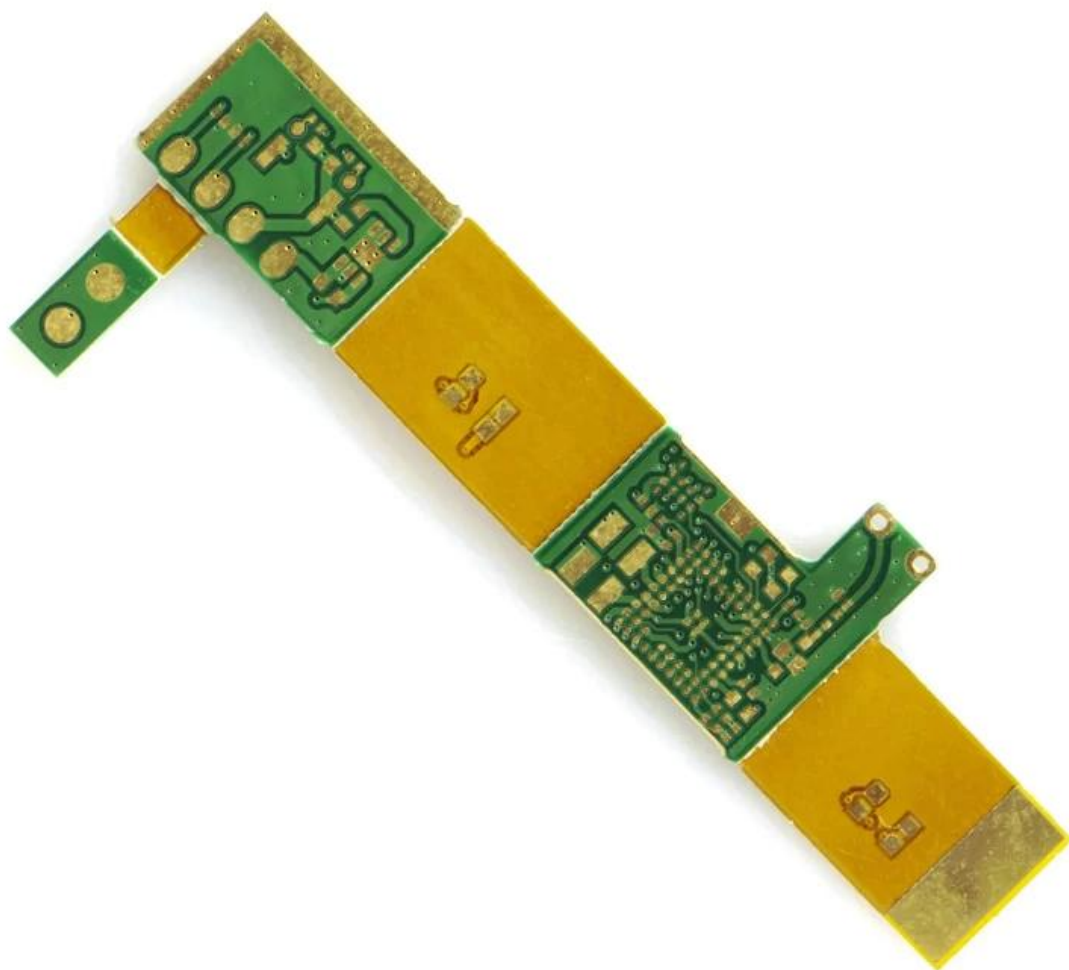
Description du produit

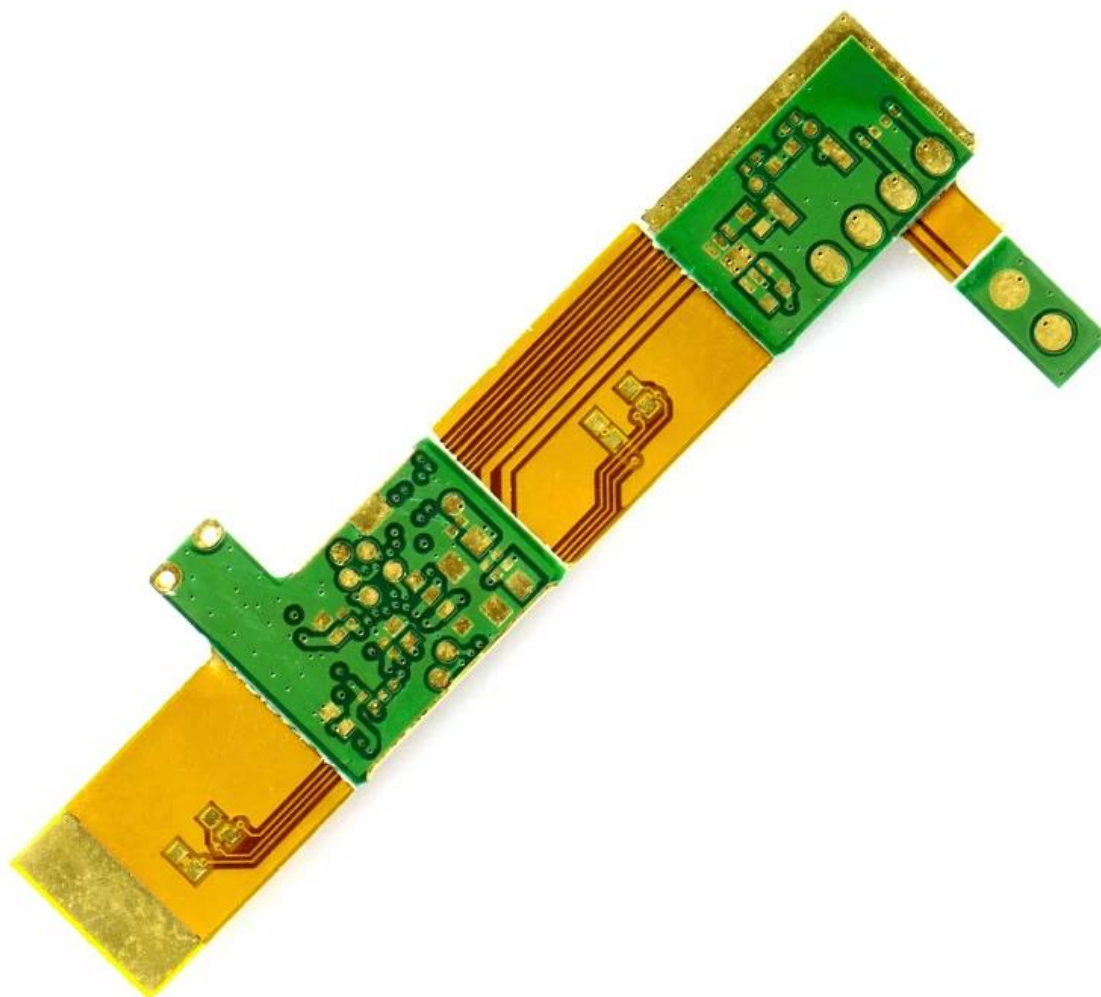


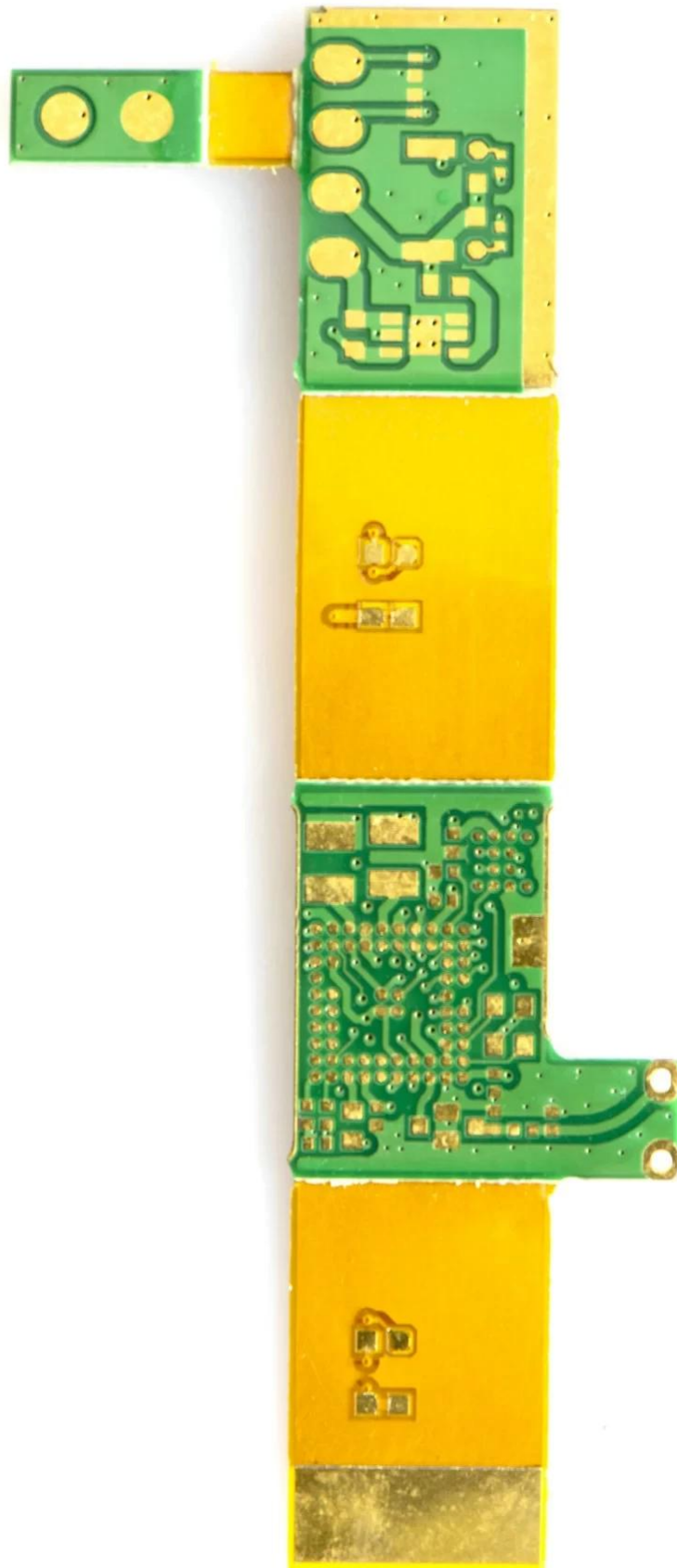
Fast delivery and top quality

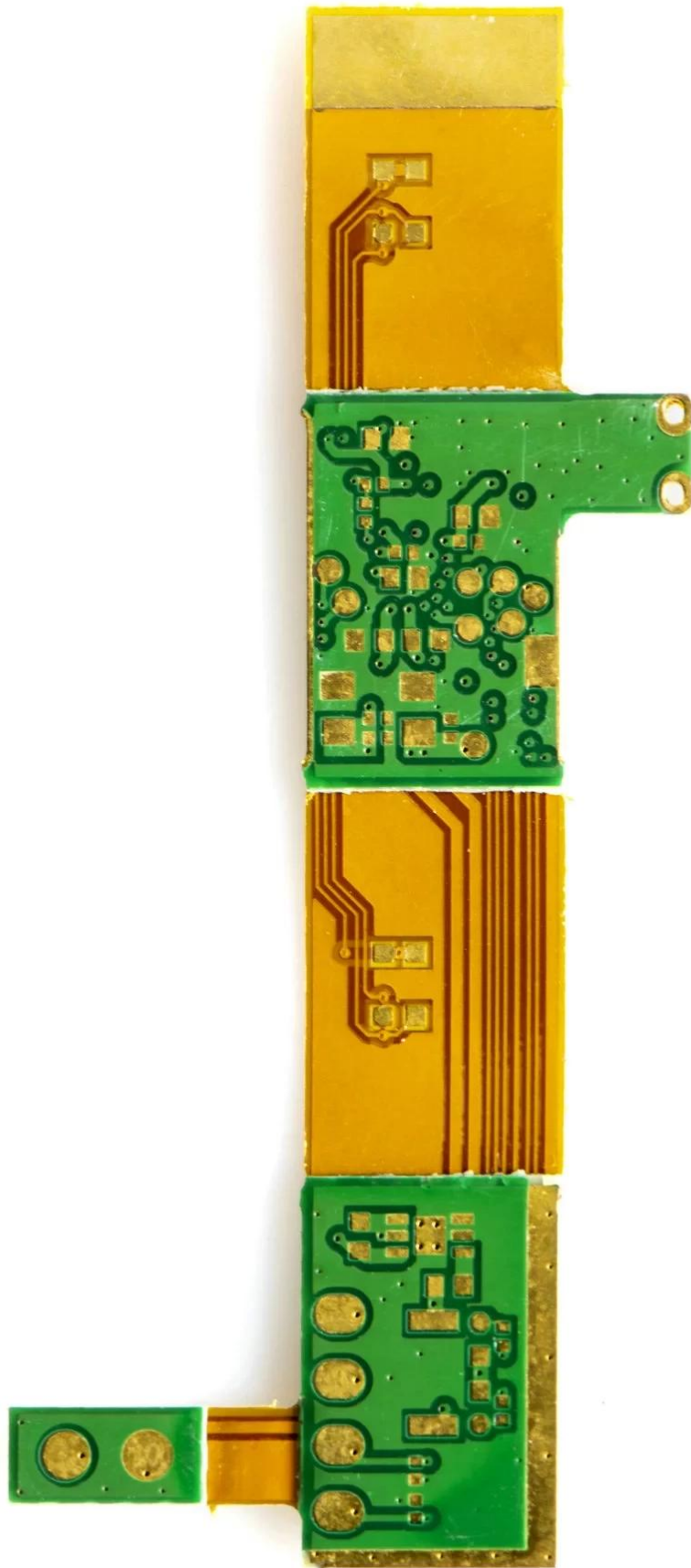
Rigid Flexible PCB











Production Process

18 years experience in one-stop PCB and PCBA, we can make your idea come true,



 CONSUMER ELECTRONICS

 AUTOMOTIVE ELECTRONICS

 INDUSTRIAL CONTROL

 INTELLECTUALIZED HOUSEHOLD CONTROL

 OTHER



30%
CONSUMER ELECTRONICS



12%
OTHER



20%
INDUSTRIAL CONTROL

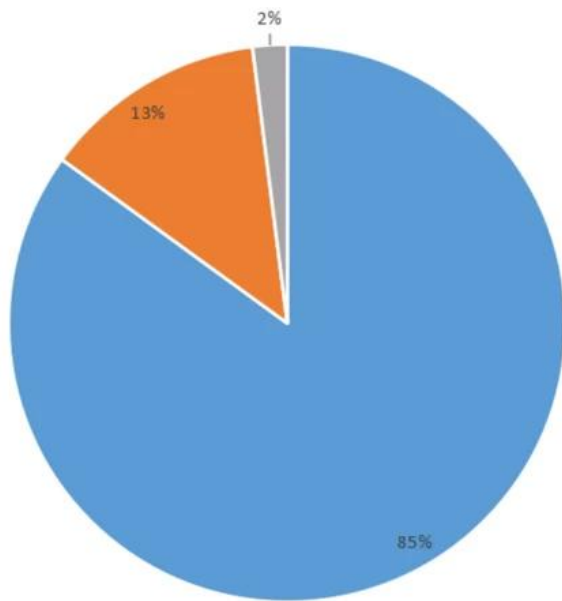


18%
INTELLECTUALIZED HOUSEHOLD CONTROL

20%
AUTOMOTIVE ELECTRONICS



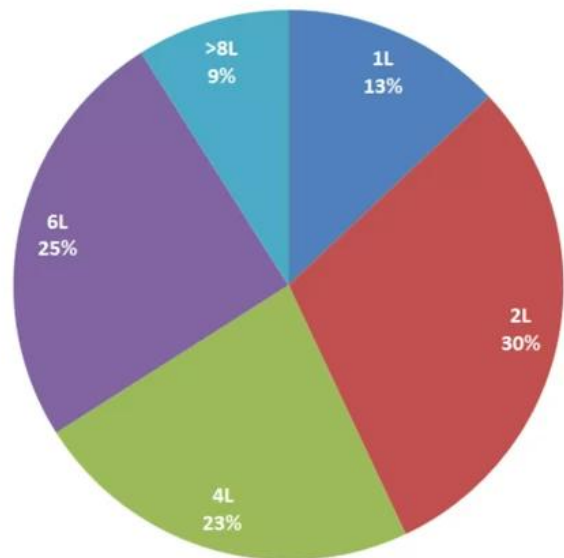
Product types



■ FR-4 PCB ■ MC PCB ■ rigid-flexible PCB

Product layers

■ 1L ■ 2L ■ 4L ■ 6L ■ >8L



Notre équipe



Factory PCB



Automatic vacuum press machine



Drilling Machine



Pattern Plating Machine



Scrubbing Machine



Developing Machine



Routing Machine



High-speed flying probe machine



E-test Machine

Factory SMT



Skyworth 创维

HET 和而泰
HET INTELLIGENT CONTROL

dongweikeji
东威科技

美的 Midea

STAR-NET
星网锐捷

FORYOU
ADAYO 华阳集团

EDIFIER®

Cultraview 金锐显

3nod 三诺

T&W

TCL

AcBel 康舒科技
ACBEL POLYTECH INC.

Honeywell

Schneider
Electric

ZTE 中兴

EMERSON

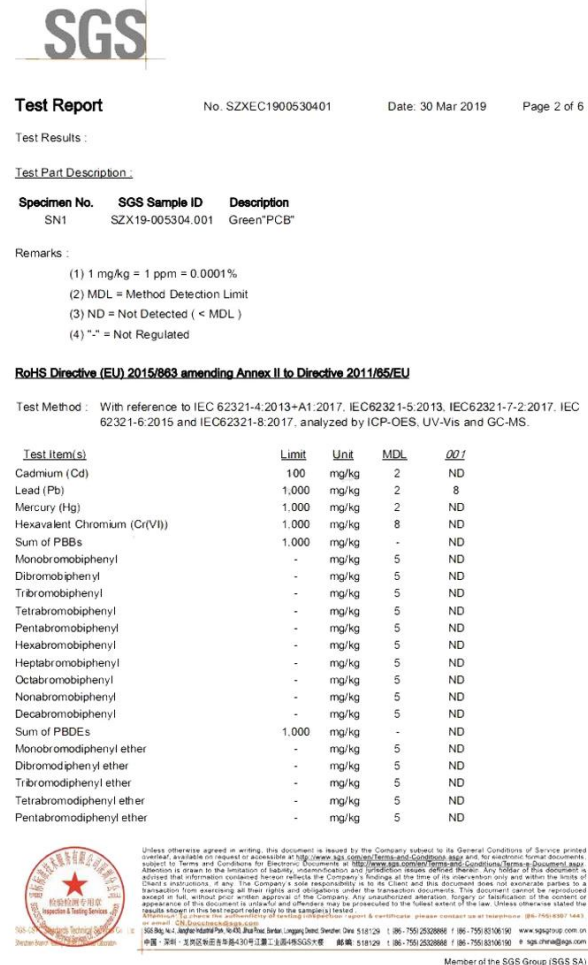
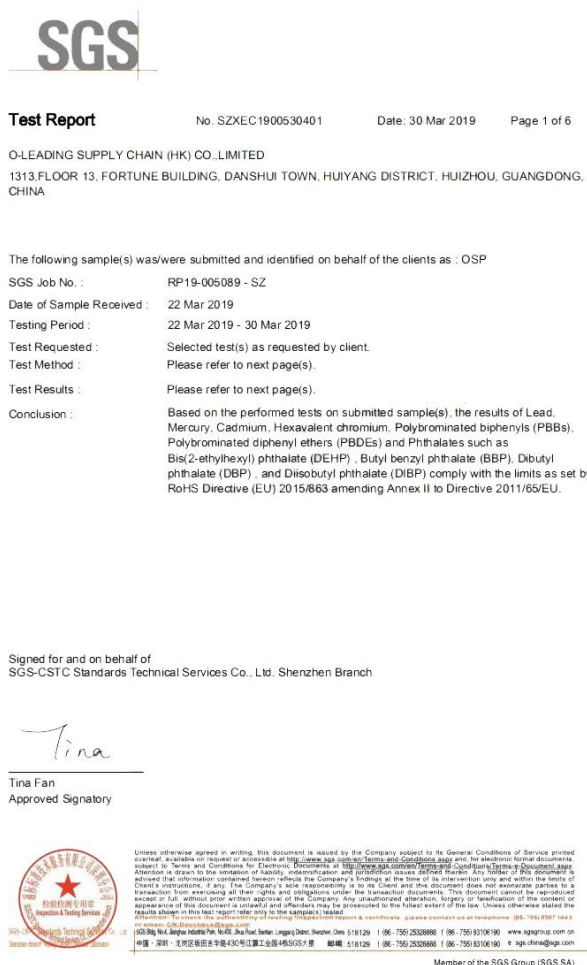
BYD

PHILIPS

TE
connectivity

VIDEOTON

Certifications





ZPMV2.E490354 - WIRING, PRINTED - COMPONENT

Wiring, Printed - Component

See General Information for Wiring, Printed - Component

O-LEADING SUPPLY CHAIN (HK) CO LTD

E490354

ROOM 1205, 12/F
TAI SANG BANK BLDG
130-132 DES VOEUS ROAD
CENTRAL, HONG KONG

Type	Cond Width		Cond Thk mic(mil)	SS/ DS/ DSO	Max		Max		Meets		C
	Min	Min			Area	Solder	Oper	Flame	UL796		
	mm(in)	mm(in)			Diam	Limits	Temp	Class	DSR		
Multilayer (mass laminate) printed wiring boards.											
O-LEADING-401	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	DS	12.7 (0.5)	260	10	130	V-0	-	-
O-LEADING-407	0.08 (0.003)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	DS	9.7 (0.4)	260	10	130	V-0	All	-
Multilayer printed wiring boards.											
O-LEADING-408	0.125 (0.005)	0.125 (0.005)	12 (0.47) Int:136	DS	50.8 (2.0)	280	20	130	V-0	All	*
Single layer printed wiring boards.											
O-LEADING-002	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	SS	19.1 (0.8)	260	10	105	V-0	All	-
O-LEADING-003	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	SS	19.1 (0.8)	260	10	130	V-0	▲	-
O-LEADING-033	0.15 (0.006)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	SS	25.4 (1.0)	260	10	120	V-0	All	-
O-LEADING-205	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	DS	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	All	-
O-LEADING-206	0.15 (0.006)	0.33 (0.013)	17 (0.67)	DS	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	All	-
O-LEADING-D01	0.14 (0.006)	0.15 (0.006)	33 (1.30)	DS	25.4 (1.0)	260	10	130	V-0	All	*
O-LEADING-S01	0.25 (0.010)	0.25 (0.010)	17 (0.67)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	V-0	All	*

WIRING, PRINTED - COMPONENT | UL Product iQ

O-LEADING-S02	0.2 (0.008)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	HB	▲	*
O-LEADING-S03	0.25 (0.010)	0.25 (0.010)	34 (1.34)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	V-0	All	*

* - CTI marking is optional and may be marked on the printed wiring board.

Marking: Company name or file number and type designation. May be followed by a suffix to denote factory identification or burning test classification.

并不是所有出现在本数据库中的公司名称和产品都满足了UL 跟踪检验服务的要求。只有带有 UL 标志的产品，才应该被视为经过UL认证，并满足UL 跟踪检验服务的要求。注意查看产品上的标志。

UL 允许在线认证目录中所含材料的复制遵循以下条件：1.指南信息、装配、构造、设计、系统和/或认证（文件）必须在不篡改任何数据（或图纸）的情况下完整且无误导性地呈现。2.“经 UL 允许从在线认证目录转载”声明必须出现在所摘取材料的邻近位置。此外，转载材料必须包含以下格式的版权声明：“© 2019 UL LLC”

Capacité du processus

Capacités de production de PCB

Nombre de couches	1Layer-32Layer
Épaisseur de cuivre fini	1 / 3oz-12oz
Largeur / espacement des lignes internes	3.0mil / 3.0mil
Largeur / espacement des lignes min externes	4,0 mil / 4,0 mil
Rapport d'aspect max	10: 1
Épaisseur du panneau	0,2 mm à 5,0 mm
Taille maximale du panneau (pouces)	635 * 1500 mm
Taille minimale du trou percé	4mil
Tolérance de trou Plated	+/- 3mil
Blind / Buried Vias (types All)	OUI
Via Fill (conducteur, non conducteur)	OUI
Matériel de base	FR-4, FR-4High Tg,Halogen free material, Rogers, Base en aluminium,Polyimide, cuivre lourd
Finitions de surface	HASL, OSP, ENIG, HAL-LF, Immersion argent,Étain d'immersion, doigts d'or, encre de carbone

Capacités de production SMT

Matériel PCB	FR-4, CEM-1, CEM-3, carte à base d'aluminium
Taille maximale du PCB	510x460mm
Taille minimale du PCB	50x50mm
Épaisseur de PCB	0,5 mm à 4,5 mm
Épaisseur du panneau	0,5-4 mm
Taille minimale des composants	0201
Composant de taille de puce standard	0603 et plus
Hauteur max des composants	15 mm
Pas de plomb min	0,3 mm
Terrain de balle BGA min	0,4 mm
Précision de placement	+/- 0,03 mm

Emballage et livraison

Shipping service



Quick Turn Lead Time		
Layer Count:	Lead Tim	Special Requirement
1L/2L	2-3days	24 Hours,48 Hours
4L	3-4days	48 Hours
6L	4-5days	72 Hours
8L	5-6days	NA
10L	6-7days	NA
12L	7-8days	NA
14L	8-9days	NA

Standard Lead Time		
Layer Count:	Sample Lead Time	Volume order lead time
2L	4 days	10 days
4L	5 days	11 days
6L	6 days	12 days
8L	8 days	14 days
10L	10 days	16 days
12L	12 days	18 days
14L	14 days	20 days
16-32L	18 days	24 days

FAQ

1. Comment O-Leading garantit-il la qualité?

Notre norme de qualité élevée est atteinte avec les éléments suivants.

- 1.1 Le processus est strictement contrôlé selon les normes ISO 9001: 2008.
- 1.2 Utilisation extensive de logiciels dans la gestion du processus de production
- 1.3 Équipements et outils de test de pointe. Par exemple. Flying Probe, X-ray Inspection, AOI (Automated Optical Inspector) and ICT (in-circuit testing).
- 1.4 Équipe d'assurance qualité dédiée avec processus d'analyse des cas de défaillance
- 1.5 Formation et éducation continues du personnel

2. Comment O-Leading maintient-il votre prix compétitif?

Au cours de la dernière décennie, les prix de nombreuses matières premières (par exemple le cuivre, les produits chimiques) ont doublé, triplé ou quadruplé; Le RMB de la monnaie chinoise s'est apprécié de 31% par rapport au dollar américain; Et notre coût de main-d'œuvre a également augmenté de manière significative.

Cependant, O-Leading a maintenu nos prix stables. Cela tient entièrement à nos innovations en matière de réduction des coûts, d'évitement des déchets et d'amélioration de l'efficacité. Nos prix sont très compétitifs dans l'industrie au même niveau de qualité.

Nous croyons en un partenariat gagnant-gagnant avec nos clients. Notre partenariat sera mutuellement

bénéfique si nous pouvons vous fournir un coût et une qualité de pointe.

3. Quels types de tableaux peuvent être dirigés par O-Leading?

Cartes FR4, TG élevées et sans halogène communes, Rogers, Arlon, Telfon, cartes à base d'aluminium / cuivre, PI, etc.

4. Quelles données sont nécessaires pour la production de PCB et PCBA?

4.1 Nomenclature avec nomenclatures de référence: description des composants, nom du fabricant et numéro de pièce.

4.2 Fichiers PCB Gerber.

4.3 Dessin de fabrication PCB et dessin d'assemblage PCBA.

4.4 Procédures d'essai.

4.5 Toutes restrictions mécaniques telles que les exigences de hauteur d'assemblage.

5. Quel est le flux de processus typique pour les PCB multicouches?

Découpe de matériau → Film sec intérieur → gravure intérieure → AOI intérieur → Multi-bond → Empilement de couches Pressage → Perçage → PTH → Placage de panneau → Film sec extérieur → Placage de motifs → Gravure extérieure → AOI extérieur → Masque de soudure → Marque de composant → Finition de surface → Acheminement → E / T → Inspection visuelle.

6. Quels sont les principaux équipements pour la fabrication HDI?

La liste des principaux équipements est la suivante: perceuse laser, presseuse, ligne VCP, machine d'exposition automatique, LDI, etc.

Les équipements que nous avons sont les meilleurs de l'industrie, les perceuses laser sont de Mitsubishi et Hitachi, les machines LDI sont de Screen (Japon), les machines d'exposition automatique sont également de Hitachi, toutes nous permettent de répondre aux exigences techniques du client.

7. Combien de types de plomb O de finition de surface peuvent faire?

O-the leader a la série complète de finitions de surface, telles que: ENIG, OSP, LF-HASL, placage à l'or (doux / dur), argent à immersion, étain, placage à l'argent, placage à l'étain à immersion, encre au carbone et etc. OSP, ENIG, OSP + ENIG couramment utilisés sur le HDI, nous vous recommandons généralement d'utiliser un client ou OSP OSP + ENIG si la taille du BGA PAD est inférieure à 0,3 mm.

8. Quelle est votre capacité pour FPC? O-Leading peut-il également fournir un service SMT?

O-Leading peut fabriquer du FPC d'une seule couche à 8 couches, la taille du panneau de travail peut être aussi grande que 2000 mm * 240 mm, veuillez trouver les détails dans la page «Flex Capability» Nous fournissons également un service unique SMT au client.

9. Quels sont les principaux facteurs qui affecteront le prix des PCB?

Matériel;

Finition de surface;

Difficulté technologique;

Différents critères de qualité;

Caractéristiques des PCB;

Modalités de paiement;

Différents pays de fabrication.

10. Quelle est la définition des PCB, PWB et FPC et quelle est la différence?

PCB est l'abréviation de Circuit imprimé;

PWB est l'abréviation de Printed Wire Board, même sens que Printed Circuit Board;

FPC est l'abréviation de Flexible Printed Board.

11. Quels facteurs devraient être pris en compte lors du choix du matériau pour une carte PCB?

Les facteurs ci-dessous doivent être pris en compte lorsque nous choisissons le matériau pour PCB:
La valeur Tg du matériau doit être supérieure à la température de fonctionnement;
Le matériau à faible CTE a de bonnes performances de stabilité thermique;
Bonnes performances de résistance thermique: Normalement, les PCB doivent résister à 250 °C pendant au moins 50 s.
Bonne planéité; Compte tenu des propriétés électriques, un matériau à faible perte / haute permittivité est utilisé sur les PCB haute fréquence; Substrat en fibre de verre polyimide utilisé pour les PCB flexibles; Le noyau métallique est utilisé lorsque le produit a des exigences strictes de dissipation thermique.

12. Quels sont les avantages du PCB rigid-flex d'O-leader?

Le PCB rigid-flex d'O-leader a les caractéristiques FPC et PCB, il peut donc être utilisé dans certains produits spéciaux. Une partie est flexible tandis que l'autre partie rigide, elle peut aider à économiser l'espace intérieur du produit, à réduire le volume du produit et à améliorer les performances.

13. Comment faites-vous le calcul de l'impédance?

Le système de contrôle d'impédance se fait à l'aide de coupons de test, du SI6000 soft et de l'équipement CITS 500 de POLAR INSTRUMENTS.

L'équipement mesure l'impédance sur un coupon de configuration de voie représentatif dont le client nous a donné une valeur et une tolérance déterminées.